

HBP1801D-2系列压力传感器模组

产品特性

- 硅压阻式MEMS技术、高灵敏度、高稳定性
- 测量范围：-100kPa ~ +1000kPa量程可选，表压
- 供电电压：1.8V ~ 5.5V可选
- 数字I²C接口
- 单气嘴DIP6封装方式，易于使用
- 适用于非腐蚀性气体或液体



典型应用

- 气泵、电机控制、工业控制、压力开关
- 气压计、高度计、气象站、导航仪
- 汽车引擎控制
- 医疗监护仪
- 液位测量、物联网压力检测

产品概述

HBP1801D-2 产品系列是豪帮高科推出的集成度高、稳定性好、可靠性优异的压力传感器模组。该产品由 MEMS 压力传感器芯片和高性能的调理电路组成。存储在 OTP 中的校准系数数据可用于产品的校准，压力校准和温度补偿由测试系统自动实现，校准后的压力和温度以数字 I²C 输出。HBP1801D-2 采用单气嘴 DIP 6 封装形式，结构紧凑，客户使用方便，并能保证产品高性能、高稳定性和高可靠性的压力测量。产品适用于非腐蚀性气体的差压检测，在医疗诊断、工业控制、汽车等领域具有广泛应用前景。图 1 是 HBP1801D-2 产品原理框图。

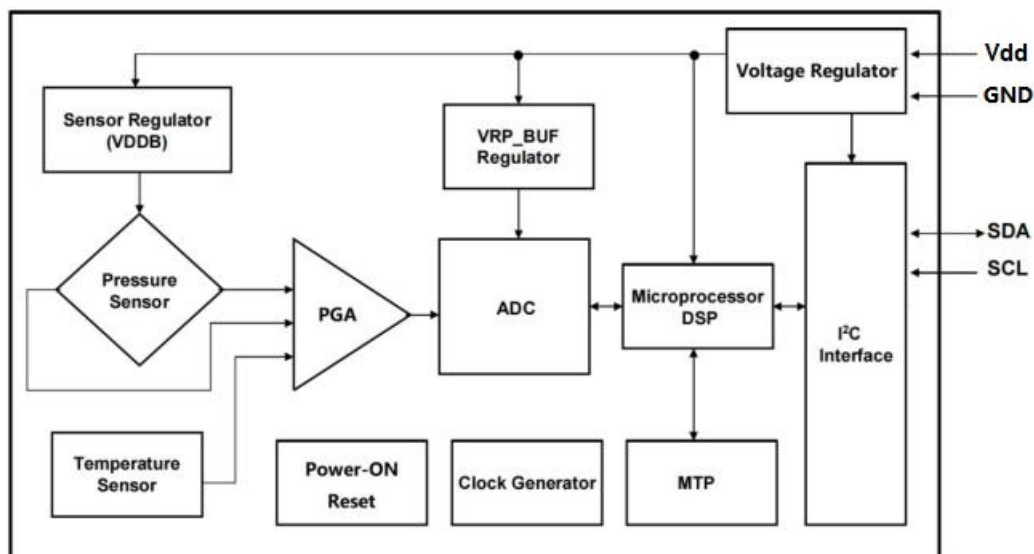


图 1: HBP1801D-2 产品框图

绝对最大额定值*

表 1: HBP1801D-2 绝对最大额定值

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压		-0.3		6.5	V
数字端电压	25°C	-0.3		Vdd+0.3	V
过载压力			2 倍		额定压力
爆破压力			3 倍		额定压力
ESD	HBM		±2		kV
存储温度		-40		125	°C
介质	非腐蚀性气体或液体				

***请注意：**超过“绝对最大额定值”的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些仅为应力额定值，并不意味着器件在这些或任何其他条件下的功能操作超出了“推荐工作条件下”所示的条件。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。

基本性能指标

表 2：HBP1801D-2 系列基本性能

性能参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
供电电压	1.8	5	5.5	V	供电电压可选
测量范围	-100		1000	kPa	量程可选
精度		±1		%FS	精度可选
零点温度漂移		±0.035		%FS/°C	
满程温度漂移		±0.035		%FS/°C	
补偿温度	0	0-60	85	°C	补偿温度可选
工作温度	-20	0-60	85	°C	温度可选
长期稳定性		±0.5		%FS	1 年

请注意：除非另有说明，上表中的数据在如下条件测试所得：测量介质为空气；大气压 (101325±500)Pa；温度 (25±2)°C；振动<0.1g(1m/s²)；湿度(50%±10%)RH；电压(5±0.25)V。

I2C 通讯协议

I2C 总线使用 SCL 和 SDA 作为信号线，这两根线都通过上拉电阻（典型值 4.7KΩ）连接到 Vddio，这样使得空闲状态都保持为高电平。A7~A1 位组成从机的地址，W/R 位是数

据传送方向位，0 表示主机向从机写数据，1 表示主机由从机读数据，如表 3 所示。

表 3: I²C 地址

A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	W/R
1	1	0	1	1	0	1	0/1

表 4: 内部寄存器信息

地址	描述	读写	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	默认值
0x00	SPI_ Ctrl	RW	SDO_ active	LSB_ first	Soft reset			Soft reset	LSB_ first	SDO_ active	0x00
0x01	Part_ID	R				PartID<7:0>			0x00		
0x02	Status	R	Error_code<5:0>			1'b0		DRDY		0x00	
0x06	DATA_MSB	R				Data out<23:16>			0x00		
0x07	DATA_CSB	R				Data out<15:8>			0x00		
0x08	DATA_LSB	R				Data out<7:0>			0x00		
0x09	TEMP_MSB	R				Temp out<15:8>			0x00		
0x0A	TEMP_LSB	R				Temp out<7:0>			0x00		
0x30	CMD	RW	Sleep_time<3:0>			Sco		Measurement_ctrl< 2:0>		0x00	
0x6C	OTP_CMD	RW	Blow start<6:0>				margin			0x00	

读取数据按照如下指令顺序进行操作：

1. 读取0xA5寄存器值，将读取到的二进制值“与”上“11111101”后再写入0xA5。
2. 发送指令0x0A到0x30寄存器进行一次温度采集，一次压力数据采集。
3. 读取0x30寄存器地址，若Sco位为0代表采集结束，可以读取数据，或等待延迟10ms
(10ms适用于OSR_P范围在256X~4096X)。
4. 读取0x06、0x07、0x08三个寄存器地址数据构成24位AD值（压力数据AD值）。

5. 将读取到的24位AD值进行如下操作计算出最终压力输出： $OUT(Pa)=AD/2^{23} \times Fullscal$ 。

注意Fullscal的取值：

eg：当满量程压力为600000Pa时， $2^{19} < 600000 < 2^{20}$ ，在24位AD中最少需要20位来表示，即此时Fullscal取 2^{20} 。

电路内部寄存器请参考如表4。其中REG0x06、REG0x07、REG0x08寄存器内为压力输出值共计24位，其中最高位为符号位，符号位数值为“1”时代表“负”，符号位数值为“0”时代表“正”。REG0x09、REG0x0A寄存器内为温度输出数值共计16位，其中最高位为符号位，符号位数值为“1”时代表“负”，符号位数值为“0”时代表“正”。I²C通讯时序值如表5所示。

表 5：I²C 通讯时序值

符号	参数	最小值	最大值	单位
f _{scl}	时钟频率		400	kHz
t _{LOW}	SCL低脉冲时间	1.3		μs
t _{HIGH}	SCL高脉冲时间	0.6		μs
t _{SUDAT}	SDA建立时间	0.1		μs
t _{HDDAT}	SDA保持时间	0		μs
t _{SUSTA}	重复启动条件的建立时间	0.6		μs
t _{HDSTA}	启动条件的保持时间	0.6		μs
t _{SUSTO}	停止条件的建立时间	0.6		μs
t _{BUF}	新的传输之前的开始时间	1.3		μs

例如假设REG0x06、REG0x07、REG0x08、REG0x09、REG0x0A读出的十进制值为x、y、z、a、b。

压力cal_AD值： $m = x \cdot 2^{16} + y \cdot 2^8 + z$

正负处理：若 $m > 2^{23}$ ，则是一个负值，压力值 $= (m - 2^{24}) / 2^{23} \cdot \text{Fullscal}$ (Pa)

若 $m < 2^{23}$ ，则是一个正值，压力值 $= m / 2^{23} \cdot \text{Fullscal}$ (Pa)

温度值： $n = a \cdot 2^8 + b$

正负处理：若 $n > 2^{15}$ ，则是一个负值，温度值 $= (n - 2^{16}) / 256$; ($^{\circ}\text{C}$)

若 $n < 2^{15}$ ，则是一个正值，温度值 $= n / 256$; ($^{\circ}\text{C}$)。

I²C 时序

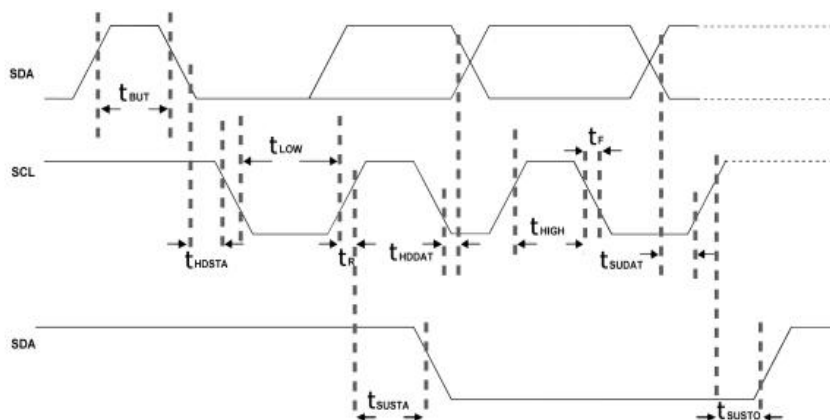


图 2：参考电路 I²C 通讯时序图

图 2 是参考电路 I²C 的时序图。从设备应答后，主设备继续发送 8 位寄存器地址，得到应答后继续发送或读取数据。SCL 处于高电平，SDA 发生一个上升沿动作标志 I²C 通信结束。除了开始和结束标志之外，当 SCL 为高时 SDA 传输的数据必须保持稳定。当 SCL 为低时 SDA 传输的值可以改变。I²C 通信中的所有数据传输以 8 位为基本单位，每 8 位数据传输之后需要一位应答信号以保持继续传输。

I²C 协议数据传输

在启动条件下 Start(S), SCL 是高电平时候, SDA 由高电平到低电平的变化, 代表开始。在停止条件下 Stop(P), SCL 依然为高电平时候, SDA 由低电平到高电平变化, 代表停止。起始和终止信号都是由主机发出, 起始信号产生后, 总线处于被占用状态, 在终止信号产生后, 总线就处于空闲状态, 如图 3 所示。

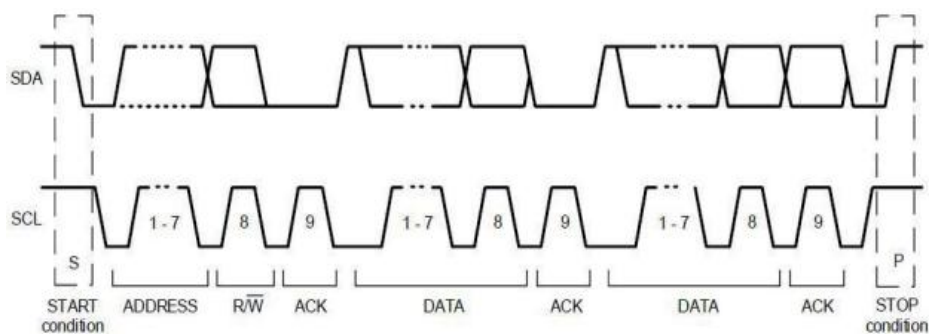


图 3: 参考电路 I²C 协议数据传输时序图

参考应用电路

HBP1801D-2 产品系列选型信息如图 4 所示。

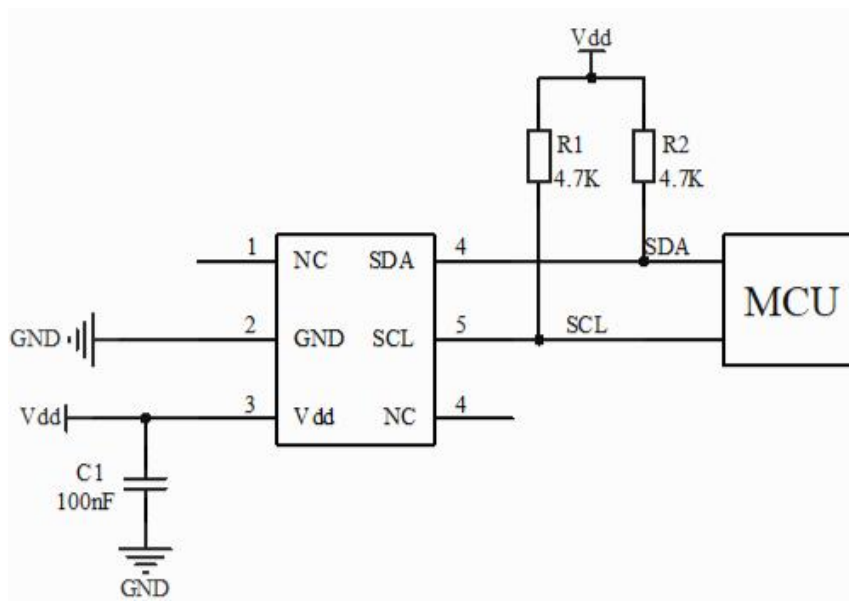


图 4: 参考应用电路

封装尺寸

HBP1801D-2 产品系列封装尺寸如下图 5，所有尺寸单位均为毫米(mm)，未标注公差均为 $\pm 0.05\text{mm}$ 。

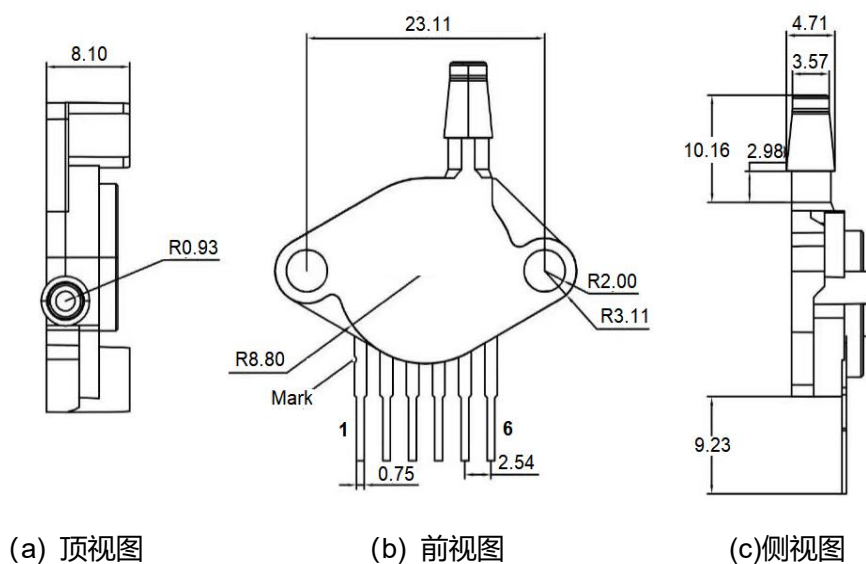


图 5: 封装尺寸图

引脚定义及功能描述

HBP1801D-2 产品系列引脚定义请参考图 6，引脚功能描述参考表 6。

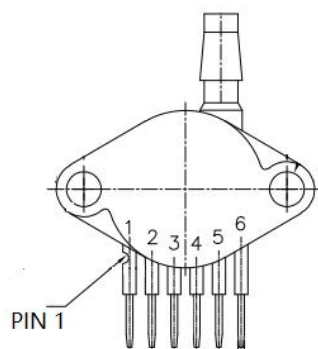


图 6: 引脚定义图

表 6: 引脚功能描述

引脚编号	1	2	3	4	5	6
定义	NC	GND	Vdd	NC	SCL	SDA
功能	空	地	供电正	空	时钟信号	数据信号

请注意:

- 1) 任何电信号不要连到 NC 脚, 否则可能会引起部分功能失效。
- 2) 焊装过程中做好防静电保护。
- 3) 过载电压(6.5VDC)可能烧毁电路芯片, 请在 Vdd 和 GND 之间加上 0.1 μ f 电容。
- 4) 本产品无反接保护, 装配时请注意电源极性。

参考回流曲线

产品 SMT 回流焊的参考温度曲线请参考图 7, 焊接工艺相关参数说明请参考表 7。

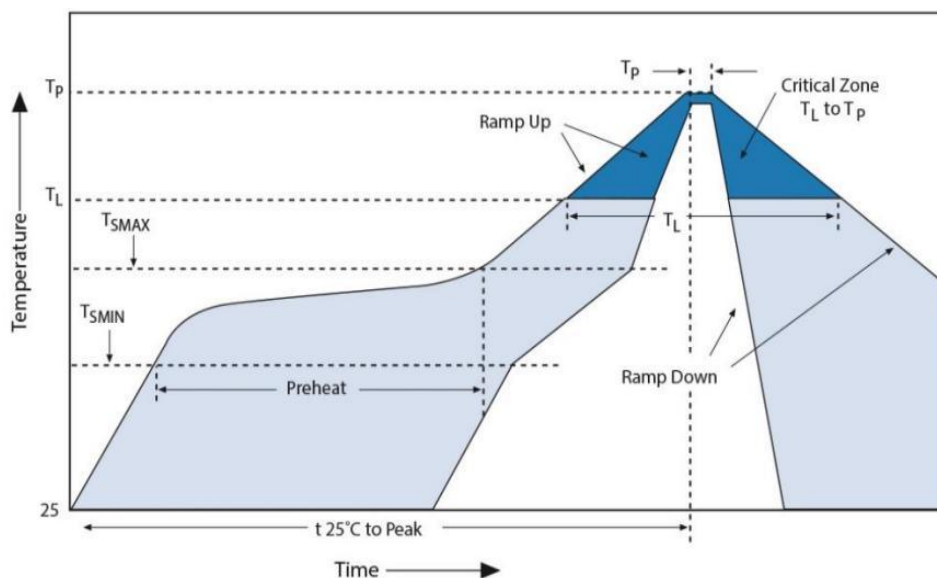


图 7: 回流焊温度曲线

表 7：回流焊参数说明

曲线特征	无铅
平均加热速率 (TSMAX 到 TP)	最快 3°C/秒
预热区最低温度(TSMIN)	150°C
预热区最高温度(TSMAX)	200°C
TSMIN 到 TSMAX (tS)	60~180 秒
回流区温度(TL)	217°C
回流区时间(tL)	60~150 秒
峰值温度 (TP)	260°C
峰值温度 $\pm$ 5°C 保持时间(tP)	20~40 秒
下降速度 (TP to TSMAX)	最大 6°C/秒
从 25°C 到峰值温度的时间	最长 8 分钟

请注意:

- 1) 传感器芯片上不允许落入灰尘中，以免影响产品性能。
- 2) 回流焊后清洗时，避免清洗剂或清洁剂侵入内部损坏产品。请不要将产品暴露在超声波处理或清洁，避免产品发生故障。
- 3) 建议回流焊次数不超过 3 次。

产品选型信息*

HBP1801D-2 产品选型信息如图 8 所示。

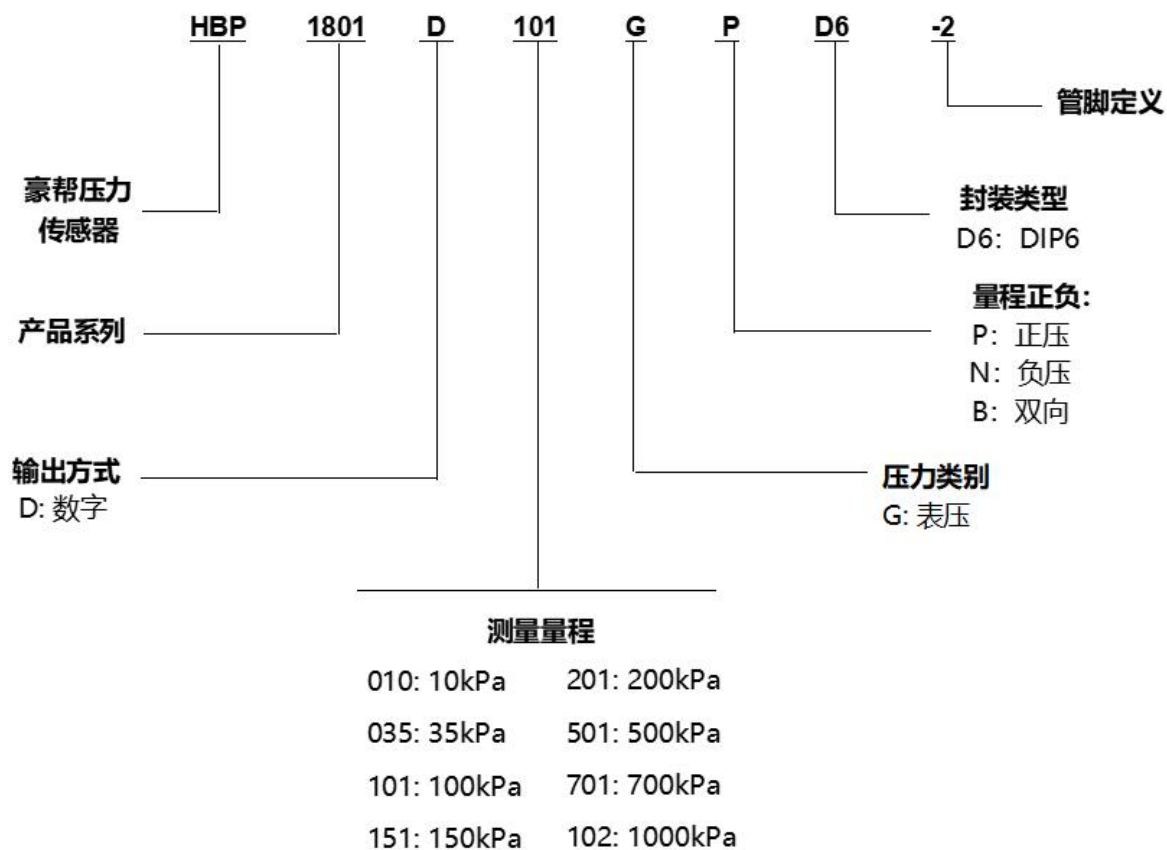


图 8: 产品选型指南图

*请注意:

- 1) 部分产品不包含以上所述的所有量程，如需更多产品信息，请联系豪帮销售人员。
- 2) 压力换算：10kPa=100hPa=100mBar≈75mmHg≈100mmH₂O≈1.45PSI

表 8：常用量程表

压力量程 (kPa)	型号
0 ~ 10	HBP1801D010GPD6-2
0 ~ 35	HBP1801D035GPD6-2
0 ~ 100	HBP1801D101GPD6-2
0 ~ 150	HBP1801D151GPD6-2
0 ~ 200	HBP1801D201GPD6-2
0 ~ 500	HBP1801D501GPD6-2
0 ~ 700	HBP1801D701GPD6-2
0 ~ 1000	HBP1801D102GPD6-2
-100 ~ 0	HBP1801D101GND6-2
-35 ~ 0	HBP1801D035GND6-2
-10 ~ 10	HBP1801D010GBD6-2
-100 ~ 100	HBP1801D101GBD6-2
-100 ~ 700	HBP1801D701GBD6-2
-100 ~ 1000	HBP1801D102GBD6-2

定制服务

豪帮切实以客户需求为导向，为客户提供灵活定制方案，以满足客户不同需求。提供包括但不限于不同量程、不同封装尺寸、不同应用范围的压力传感器器件和压力传感器模组等有效定制服务。如需了解更多信息，敬请联系 info@haobang-smt.com。

版本修订记录

表 9：版本修订记录

版本	描述	日期
1.0	首次发行	2025 年 3 月